

乙烯基硅树脂 RH-S6124

主要组份

甲基乙烯基 MQ 硅树脂与乙烯基封端聚二甲基硅氧烷混合物

性能指标

外 观	淡黄色透明液体
树脂含量	20%
粘度（25℃，mpa.s）	4800-5800
乙烯基含量（wt%）	0.49-0.53
挥发份（wt%）	≤1.0%

特 性

本产品由乙烯基硅油和乙烯基硅树脂混合调配而成，与乙烯基硅油和含氢硅油调配，可制成中低硬度的产品，广泛用于电子灌封胶。适当添加于加成型硅橡胶配方中，可提高其硬度，撕裂强度等。具有耐高温、电气绝缘、防潮、防水等优良性能。可溶于低粘度的乙烯基硅油、甲苯、120#汽油等。

用 途

1. 表面处理剂：如用于有机硅压敏胶、手机按键、环氧类粘接剂粘接表面等；
2. 补强填料：可用于 RTV 胶、HTV 胶、加成型液体硅橡胶、热硫化硅橡胶混炼胶、半导体元器件的无壳灌封；
3. 增粘剂：用于建筑密封胶、涂料、高温云母板及玻纤布层压板等理想的粘接剂；
4. 其它添加剂：配制脱膜剂、消泡剂、防粘剂及光亮剂、加成型防粘剂的剥离力调节剂等，还可用作大理石、地板砖耐磨、抛光处理。

贮 存

防止日光直照暴晒，远离明火，保持通风干燥。贮存期 2 年。

特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值，仅供参考，不作为产品验收标准，恕不经预告更改。由于使用条件的差异，我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性，不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。